

複合銅厚基板 R&D

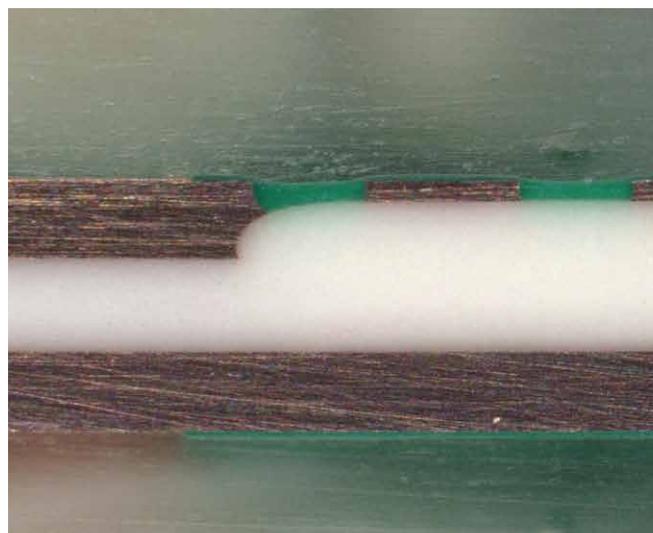
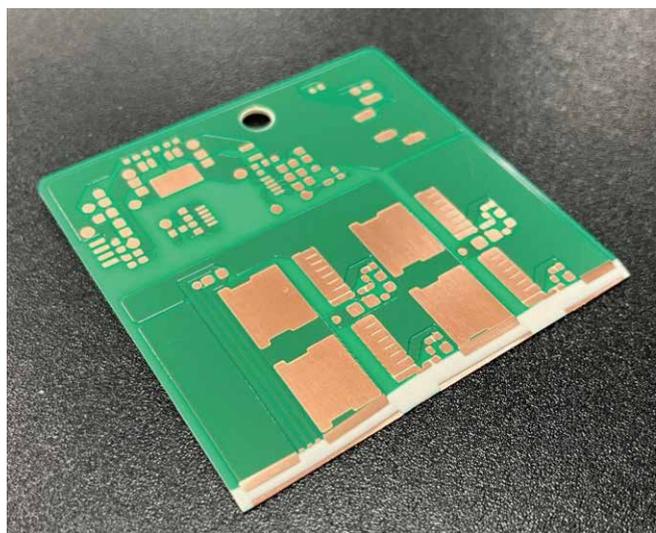
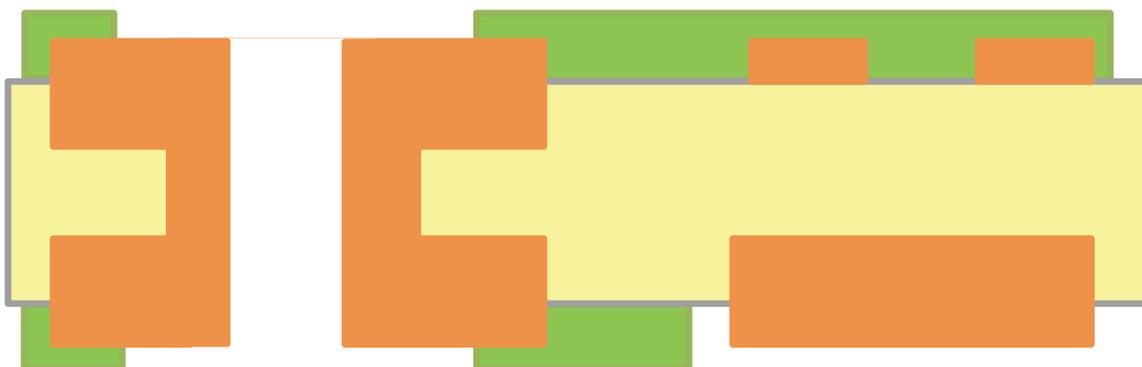
Dual thickness copper layer PCB

特長 Features

大電流回路と制御回路を同一層に形成可能

- 放熱／大電流部は導体厚を厚くして対応
- 制御回路部は導体厚を薄くし、回路密度を高くすることが可能
- 絶縁樹脂に放熱樹脂を使用することで低熱抵抗を実現
- スルーホール/メガスルホール対応で更なる低熱抵抗化が可能

構造イメージ



サンプルスペック

厚銅部：300 μm / 回路部：100 μm